客户 CUSTOMER: 日期 DATE:

纳入仕样书
SPECIFICATION

产 品 名 称 PRODUCT NAME: Diplexer
贵 司 料 号 YOUR PART NO.:
敝 司 料 号 OUR PART NO.: MDPX21M1925P69-D27
版 本 号 VERSION.: V1.0

接受 RECEPTION THE SPECIFICATION HAS BEEN ACCEPTED. 该纳入仕样书已被我司接受 日期: DATE： 公司： COMPANY：		
批准 CFMD	审核 CHKD	接收 RCVD

本纳入仕样书共 12 页

MANUFACTURING NAME

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO。，LTD
TEL：86-755-28085000
FAX：86-755-28085605

CFMD. 批准	CHKD. 审核	DSGD. 担当
梁启新	付迎华	曾艳峰

纳入仕样书改定履历 MODIFY HISTORY OF SPECIFICATION

NO.	DATE	CONTENT	APPROVED
1	2019.03.20	初稿 Constitute	梁启新

目录 CATALOG

1 适用范围 Scope

麦捷 Diplexer（MDPX 系列）产品设计用于 PHS、WLAN、GSM、Bluetooth、PDA 和无绳电话机中，具有低的插入损耗、高的衰减和小体积 SMD 片式设计，能减少复杂的调校工作，可以简化电路设计。

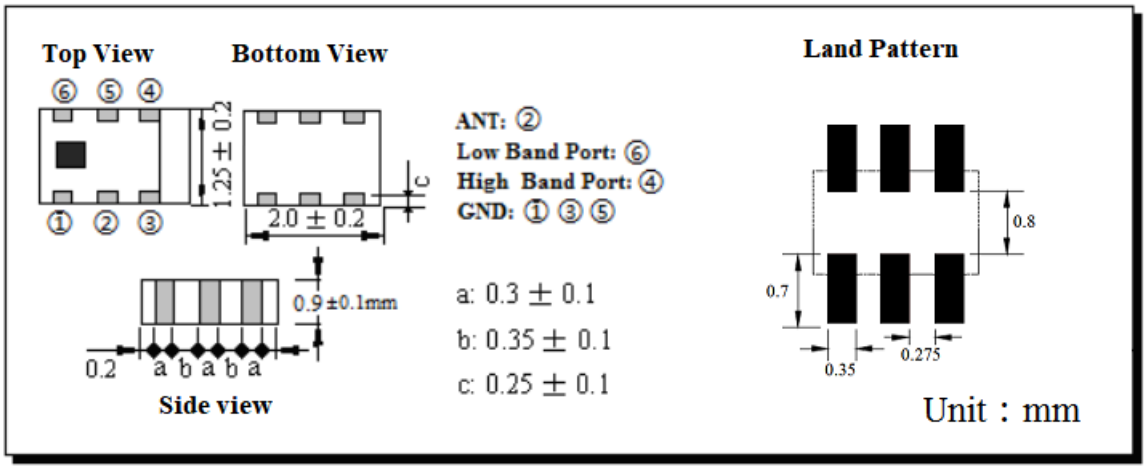
"Microgate" Microwave Diplexer series are designed to be used in PHS, WLAN, GSM, Bluetooth, PDA & Cordless phones with low insertion loss and high attenuation as well as small size SMD chip design, which can simplify your complex tuning and circuit design.

2 品名构成 Product Identification

MDPX 21 M1925 P69 – D27

- D27：标准规格，编号 D27/Norma Type: D27
- P69：平面结构/Plane Design Series: P69
- M1925：模块/ Module: 1900MHz/2500MHz
- 21：产品尺寸/Chip Size：2.0mm×1.25mm
- MDPX：多层结构双工器 / Multilayer Diplexer

3 形状、尺寸和材料 Appearance, Dimensions and Material



Part Name 名称	Structure and Material 结构及材料
Resonator 谐振体	Dielectric Material LTCC 介质材料
In/Output Terminals 输入/输出	Ag 银
Ground Base 接地面	Ag 银

4 测试条件 Testing Conditions

除非另有规定，否则在以下条件下测试 <Unless otherwise specified>

温度 Temperature : Ordinary Temperature (5 to 35℃)

湿度 Humidity : Ordinary Humidity (25 to 85% RH)

大气压强 Atmospheric Pressure : 86 to 106 kPa

当对测量结果有疑问时<In case of doubt>

温度 Temperature : 20±2℃

湿度 Humidity : 60 to 75% RH

大气压强 Atmospheric Pressure : 86 to 106 kPa

5 电气性能 Electrical Characteristics

操作温度范围 Operating Temperature Range : -40 to +85℃

保存温度范围 Storage Temperature Range : -40 to +85℃

No.	Item （项目）		Frequency（MHz）	Specifications （特性）
5.1	Insertion Loss （in f1） 插入衰耗		698~1920 MHz	≤0.6dB Max.@ (25°C±5°C) ≤0.65dB Max. @ (-40°C~+85°C)
5.2	Insertion Loss （in f2） 插入衰耗		2496~2690 MHz	≤0.7dB@ (25°C±5°C) ≤0.8dB@ (-40°C~+85°C)
5.3	V.S.W.R (in BW) 驻波比（in f1 & f2）		698~1920 MHz 2496~2690 MHz	≤1.9
5.4	Attenuation 阻带衰耗 （in f1）		2496~2690MHz 5150~5850MHz	≥17dB ≥20dB
5.5	Attenuation 阻带衰耗 （in f2）		698~960MHz 1710~1880MHz 1880~1920MHz	≥20dB ≥17dB ≥17dB
5.6	Isolation 隔离度	Low Band to High Band	2496~2690MHz 5150~5850MHz	≥20dB ≥17dB
		High Band to Low Band	698~960MHz 1710~1880MHz 1880~1920MHz	≥17dB ≥17dB ≥20dB
5.7	Power Capacity（Max.） 功率容量			2.0 W
5.8	In/Output Impedance 输入/输出阻抗			50 Ω

6 焊接条件 Recommended Soldering Conditions

1、焊剂 Flux, Solder

① 使用松香助焊剂，禁止使用卤化物含量起过 0.2wt%的强酸性助焊剂。

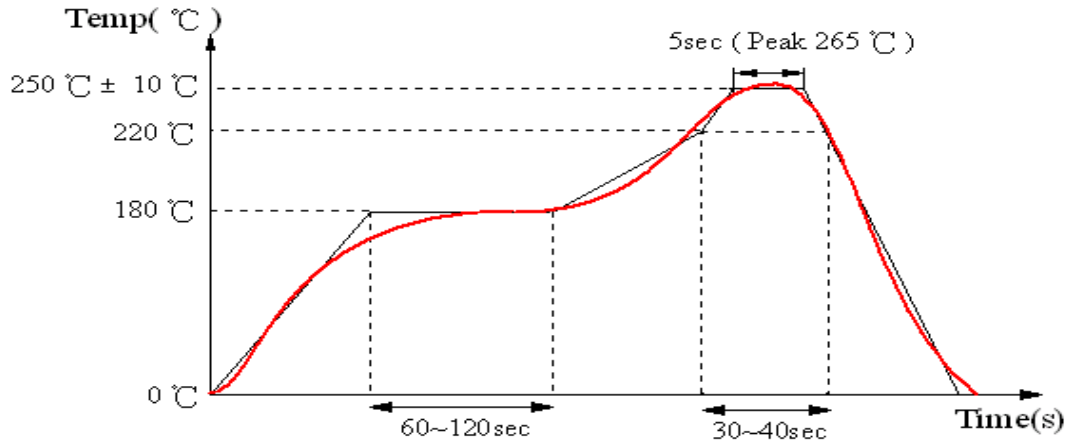
Use rosin-based flux. Don't use highly acidic flux with halide content exceeding value).

② 使用纯锡焊料 Use Sn solder.

2、回流焊条件 Reflow soldering conditions

●预热时，产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃，焊接完后冷却时，产品表温与溶剂温度之间的温差最大不允许超出 100℃。预热不足有可能引发产品表面裂纹，导致产品品质下降。Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and product surface is limited to 150℃ max. Cooling into solvent after soldering also should be in such a way that temperature difference is limited to 100℃ max. Unwrought pre-heating may cause cracks on the product, resulting in the deterioration of products quality.

●标准回流焊曲线 Standard soldering profile.



3、手工返工 Reworking with soldering iron

当使用电烙铁进行手工焊接时，以下条件必须严格遵守 The following conditions must be strictly followed when using a soldering iron.

预热 Pre-heating	150℃, 1 minute
尖端温度 Tip temperature	350℃ max
输出功率 Soldering iron output	80w max
电烙铁头尖端尺寸 End of soldering iron	φ3mm max
焊接时间 Soldering time	3 seconds max